

ガラスインターポーター・TGV用ガラス基板の特性とVia加工技術

<https://www.rdsc.co.jp/seminar/260258>

◆日 時：2026年02月25日（水） 13:30～16:00

◆会 場：WEBセミナー（オンライン開催）

◆聴講料：1名につき44,000円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申し込みされた場合、1名につき40,700円（税込）

・2名同時でお申し込みされた場合、2名で44,000円（税込）

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：イトウデバイスコンサルティング 代表 博士(工学) 伊藤 丈二 氏

【講座の趣旨】

本講演では、ガラスインターポーター・TGV用ガラス基板に求められる特性としての基板反りとガラスの電気特性及びガラスの成形性を解説する。Via加工技術に関して、エッチングとレーザ並びにエッチングとレーザを組み合わせた技術を紹介する。Via加工時に発生する欠陥と欠陥がもたらす評価・検査に対する課題にも触れる。更に提案されているガラスの電気・物理特性に対して総括した後、ガラス基板への半導体パッケージトレンドからの影響と現在検討されているガラスセラミックスや極薄ガラスの積層化について紹介する。最後に半導体用パッケージガラスの課題を示す。

【プログラム】

1. ガラスインターポーター・TGV用ガラス基板に求められる特性と形状
 - 1-1 ガラスコア基板とガラスインターポーター
 - 1-2 ガラスインターポーター・TGV用基板の反りに影響する特性
 - 1-3 電気特性としての比誘電率と誘電正接
 - 1-4 ガラスの成形性

2. Via加工技術

- 2-1 エッチング(ウェットとドライ)による穴あけ
- 2-2 レーザによる穴あけ
- 2-3 レーザとエッチングの組み合わせた穴あけ

3. 半導体パッケージ用ガラスの機械的信頼性

- 3-1 Via加工時のダメージ
- 3-2 ガラスインターポーター・TGVの評価と検査方法の課題

4. ガラスインターポーター・TGV用ガラスの候補

- 4-1 電気特性と物理特性のまとめ
- 4-2 フラットパネルディスプレイ用ガラスとの特性比較
- 4-3 ガラス組成と電気・物理特性との関係

5. 今後のガラスインターポーター・TGV用ガラス

- 5-1 半導体チップ(チップレットを含めた)からの影響
- 5-2 ガラスセラミックスの可能性
- 5-3 極薄ガラスの積層化の提案

6. 半導体パッケージガラスの課題

『ガラスインターポーター【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社名			
住所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属・役職	E-mail	
①			
②			
会員登録（無料）	<input type="checkbox"/> Eメール <input type="checkbox"/> 郵送 ※ご希望の案内方法を選択してください。複数選択可。		

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項を記入のうえ、FAXにてお申し込みください。弊社で内容を確認後、受領のご連絡を差し上げます。受講用URLは後日お送りいたします。

なお、お申し込み後のキャンセルは原則として承っておりません。ご都合により出席できない場合は、代理の方にご出席いただくようお願いいたします。代理の方も見つからない場合は、(土日祝日を除く)8日前までにご連絡いただければキャンセルを承ります。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。

⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。

⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>